

证券代码：301200

证券简称：大族数控

## 深圳市大族数控科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华创证券（8月16日） 中金公司（8月16日） 永赢基金（8月19日） 中信证券（8月19日） 易方达基金（8月21日） 中泰证券（8月21日）
时间	2024年8月16日-2024年8月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司 2024 年上半年经营情况</b></p> <p>自 2023 年四季度以来，下游消费电子市场逐步回暖，同时受益于 AI 算力需求增长带来的 PCB 需求回升，带动专用加工设备市场需求增加，报告期内，公司各系列产品全面恢复成长，实现营业收入 156,436.29 万元，较去年同期大幅增长 102.89%，归属上市公司股东的净利润 14,321.91 万元，较去年同期增长 50.07%。</p> <p><b>二、公司所处行业情况</b></p> <p>PCB 作为电子产品之母，是电子元器件的支柱和连接电路的桥梁，支撑电子信息产业快速发展，是各行业技术进步越来越重要的</p>

载体。2024 年以来，随着消费电子终端库存逐步消化，电子产业走出低谷，加上 AI 算力需求爆发的推动，PCB 产业重回成长通道。

从长期来看，AI 算力产业链从数字基建到应用终端逐步发展，对高速通讯设备、高端 AI 服务器、大型数据中心等基础设施及 AI 手机、AI PC 等终端的需求显著增加，AI 相关电子终端产品已成为 PCB 产业发展的新一轮推动要素，未来大尺寸封装基板、高多层板及 HDI 板等产品需求的增加将带动行业的持续投资，促进专用加工设备市场的不断成长；另一方面，受电动化、智能化驱动，汽车电子零部件成本占比大幅攀升，拉动整车的 PCB 需求量，进一步推动 PCB 产业长期向好发展。

### 三、多层板及高多层板市场业务情况

公司始终坚持在多层板市场的产品创新，打造各工序协同的大族数控整体加工方案，2024 年推出的第二代钻房自动化方案，搭配十二轴机械钻孔机、大族 MES 系统及涂层钻针等产品，在部分应用场景的综合效率最高超过传统六轴机的 120%；加上高功率阻焊激光直接成像系统、自动上下料机械成型机、电测与自动外观检查一体机、自动分拣包装机等产品方案，可大幅提升客户端设备稼动率及产品品质；另外，公司布局的自动压合系统、双面在线式光学检查机（AOI）等新产品受到客户高度认可，订单不断增加，为 PCB 企业降本增效提供有力支撑。

而在高多层板市场，针对 AI 服务器、高速交换机等终端采用更高层数、更高密度的高速多层板，公司推出的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机、高功率及能量实时监测的 CO<sub>2</sub> 激光钻孔机、高性能激光直接成像系统、大台面六倍密通用测试机及 CCD 四线测试机产品，可充分满足服务器等大厚板高品质、高可靠性加工，确保高速 PCB 的信号完整性，助力下游客户快速进入增长强劲的高多层板市场，提升公司在该市场的营收水平。

### 四、HDI 及封装基板市场拓展情况

在传统及任意层 HDI 市场，HDI 板的特征尺寸进一步微缩，公司持续升级四光束 CO<sub>2</sub> 激光钻孔机、高解析度激光直接成像系统及高精测试机等产品性能，以满足该市场不断提升的技术要求。另外，AI 智能手机及光模块越来越多采用类载板，带动了微小盲孔等高精度加工专用设备需求，公司提供新型激光加工方案，可满足

	<p>微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工要求，为行业新兴应用提供新动力。</p> <p>针对大尺寸 FC-BGA 高阶封装基板 ABF 增层数增加及特征尺寸变小等特点，公司创新运用新型激光加工技术，开发出用于玻璃基板产品在内的先进封装基板多制程成套加工方案，相关设备及工艺方案已获得行业头部客户的认证及正式订单，未来公司高附加值产品销售占比将进一步提升。</p> <p><b>五、海外市场情况</b></p> <p>受终端客户供应链策略的调整，东南亚地区泰国、越南及马来西亚等 PCB 产业新兴热土的投资进度加速，2024 年以来，众多国内及台资企业在东南亚市场的项目陆续落地，公司与国内多家知名厂商的泰国工厂及泰国 KCE 等当地较大规模的企业达成全面合作，相关订单显著增长。公司积极组建海外运营团队，与内资企业联合打造高水平自动化产线，减少对技术人员的依赖，确保相关企业海外 PCB 产能稳定供应。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 21 日